



NEWS RELEASE

報道資料

2009年12月1日

(日本時間)

アプライド マテリアルズ

業界最先端の高生産性 CMP 装置 Applied Reflexion GT を発表

アプライド マテリアルズ (Applied Materials, Inc., Nasdaq : AMAT、本社 : 米国カリフォルニア州サンタクララ、会長兼 CEO マイケル・スプリンター) は 12 月 1 日 (日本時間)、先進的なメタル CMP (化学機械平坦化) プロセスを低いコストオブオーナーシップ (CoO) で達成 できる CMP 装置 Applied Reflexion® GT を発表しました。この装置は画期的なデュアルウェーハアーキテクチャーを採用し、優れたプロファイル制御性能を発揮するほか、スループットは競合する他の装置を 60%上回るなど、CMP 性能と生産性を一段と高めています。また、スラリー使用量は 30%減少し、研磨パッド 1 枚当たりのウェーハ処理枚数も 2 倍に増えるので、消耗品コストを大幅に削減することができます。

アプライド マテリアルズの CMP ビジネスユニット ジェネラルマネージャー、ラクシュマナン・カルuppiaは次のように述べています。「現在の Cu ベースのロジックやメモリデバイスでは、以前より多くの Cu 配線層が用いられるので、CMP プロセスの高速化と消耗品利用の効率化が求められています。Reflexion GT は、好評を博したアプライド マテリアルズの Producer® GT™ CVD プラットフォームと同様にお客様の要望をかなえるドリームマシンとして、革新的な CMP 技術とデュアルウェーハ処理を組み合わせ、クラス最高の性能を実現しています。この新しいアーキテクチャーは抜群のスループット速度に加えて、ウェーハコストの 70%を占める消耗品コストを大幅に削減することができます」

Reflexion GT の際立った性能を支えるのが、Titan Contour™研磨ヘッド 2 基を独立制御して同時に 2 枚のウェーハを処理するデュアルモードアーキテクチャーです。研磨が終了したウェーハは、アプライド マテリアルズの実績ある Marangoni™ベーパー乾燥技術を搭載したパラレルパス洗浄モジュールにより、ウォーターマークの発生を抑える効率的な洗浄が行われます。さらにプロファイルとエンドポイントをリアルタイムで制御する独自技術により、ウェーハ間の研磨均一性を業界最高レベルに高めています。

Reflexion GT は、Cu 配線層の平坦化プロセスを対象として提供されますが、タングステンアプリケーションにも拡張利用できることが実証されています。CMP 技術を 10 年にわたってリードし、世界各地のお客様に 2,700 台以上を納入してきたアプライド マテリアルズの優位は、この革新的な装置によってさらに強化されます。

製品の詳細についてはホームページをご覧ください：

www.appliedmaterials.com/products/reflexion_gt_cmp_4.html

アプライド マテリアルズは、半導体チップ、フラットパネル、太陽電池、フレキシブルエレクトロニクス、省エネガラスの製造におけるイノベティブな装置、サービスおよびソフトウェア製品を幅広く提供する Nanomanufacturing Technology™ ソリューションのグローバルリーダーです。アプライド マテリアルズは、人々のライフスタイルを向上させるナノマニュファクチャリングテクノロジーを提供します。

詳しい情報はホームページ：<http://www.appliedmaterials.com> でもご覧いただけます。

このリリースは 12 月 1 日日本においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:渡辺徹)は 1979 年 10 月に設立。大阪支店ほか 12 のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ
投資家関係：

Applied Materials, Inc.

インベスターリレーションズ: 矢野 悦子 (Tel: +1-408-986-2646)

etsuko_joslen@amat.com

メディア関係：

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社

社長室: 大橋 百合 (Tel: 03-6812-6801)

ホームページ: <http://www.appliedmaterials.com>
